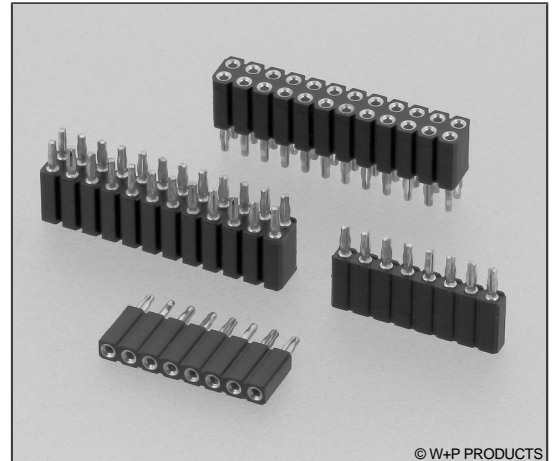


# 153PF-38

## Press-Fit Präz.-Buchsenleisten RM 2,54mm, 1-/2-reihig Press-Fit Precision Female Headers Single Row Double Row, 2,54mm Pitch

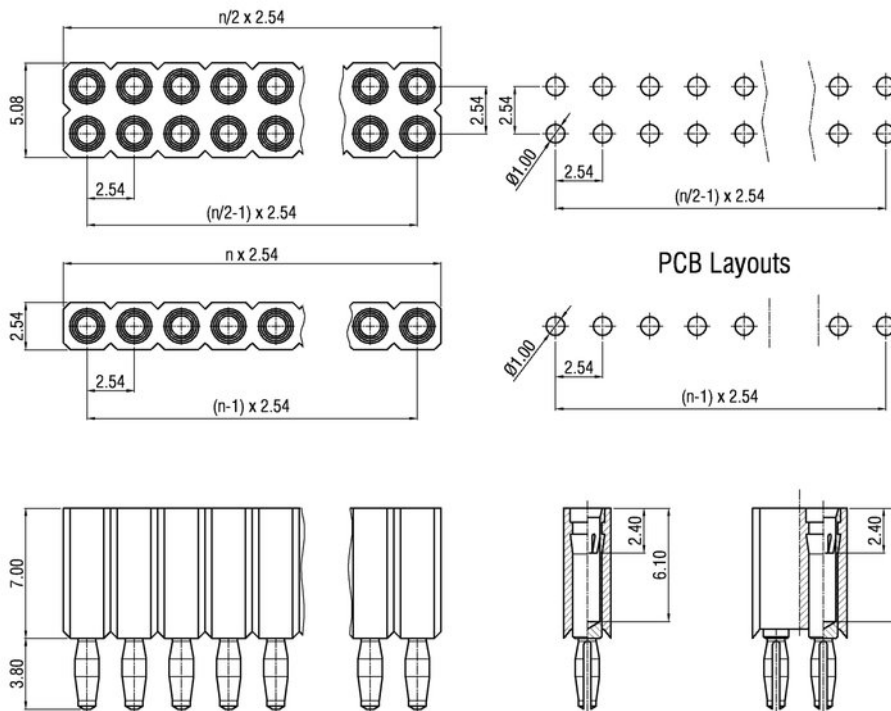
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Phosphorbronze gedreht Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined phosphor bronze</i> <i>Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>RMS</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C



© W+P PRODUCTS

Wie 153PF, aber mit längerer Press-Fit-Zone für Leiterplatten dicker als 1,6mm.  
*As 153PF, but with longer Press-Fit Zone for PCBs thicker than 1.6mm.*  
Einsetzbar für Rundstifte Ø0.65-0.85mm oder Vierkantstifte 0.635mm.  
*Accept Ø0.65-0.85mm round pins or 0.635mm square pins.*



Einpresszone s. Tech. Informationen.  
*See technical Information for PressFit zones.*

### Series

**153PF-38**

### Contacts\*

**010**

**002-050** Einreihig  
*Single row*  
**004-100** Zweireihig  
*Double row*

### Rows\*

**1**

**1** Einreihig  
*Single row*  
**2** Zweireihig  
*Double row*

### Sleeve Plating

**50**

**50** Hülse verzinkt  
*Tin plated sleeve*

### Clip Plating\*

**00**

**00** Feder vergoldet  
*Gold plated clip*  
**10** Feder 0,25µm Gold (Option)  
*0.25µm gold plated clip (Option)*  
**30** Feder 0,75µm Gold  
*0.75µm gold plated clip*  
**50** Verzinkt  
*Tin plated*

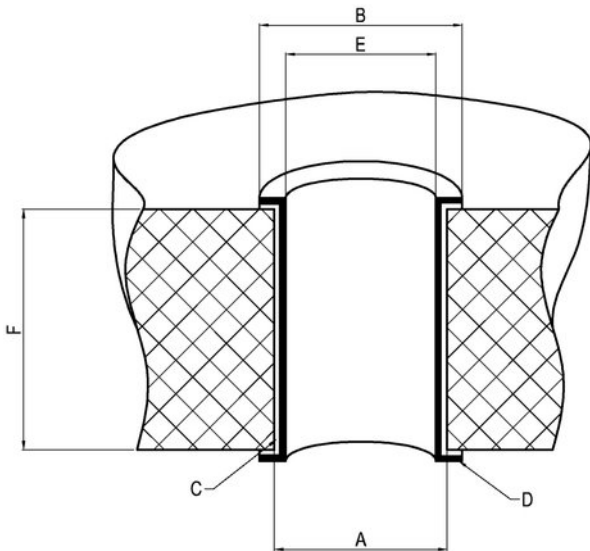
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# PressFit Lochdefinitionen

## PressFit Hole Definitions

### Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



<b>A</b>	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
<b>B</b>	Ring-Ø	Ring Ø
<b>C</b>	Cu-Schicht	Cu Layer
<b>D</b>	Veredelung	Plating
<b>E</b>	Endloch-Ø	Final Hole Ø
<b>F</b>	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]
					Sn	Au/Ni		
<b>943PF, 944PF</b> <b>943PFS,</b> <b>944PFS</b>	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60
<b>314PF</b>	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60
<b>153PF</b>	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60
<b>153PF-38</b>	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 2,50
<b>138PF</b>	2,54	1,00±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60